

**MALA REPRODUCCION
POR DEFECTO DEL ORIGINAL**

207119



1953

207119

MEMORIA DESCRIPTIVA que forma parte integrante de la PATENTE DE INVENCION cuyo registro en el de la Propiedad Industrial, se solicita en España a nombre de los Sres. José Sancho, Ingeniero S.L., Sociedad española, domiciliada en Valencia, Dania 39, por: "Un dispositivo para efectuar la unión del fondo o base en los envases de material plástico".

Los envases de material plástico se fabrican generalmente de una sola pieza, lo que origina en la práctica la fragilidad de los mismos, principalmente cuando se emplea su elasticidad como medio de originar una presión para la salida de los líquidos, oprimiéndolos a tal fin.

Estos perjuicios se evitan construyéndolos de dos piezas una que forma el cuerpo del envase con su correspondiente boca de salida y otra, el fondo, siendo de gran importancia que la unión de ambas piezas sea lo más perfecta posible y elimine los peligros de rotura.

A ello tiende el dispositivo para soldar ambas piezas, objeto de la presente patente.

Según esta patente el cuerpo del envase, sin fondo y este último, han de efectuar su unión por soldadura, efectuándose esta mediante el dispositivo que a continuación se describe.

Consta este dispositivo de una pieza que representa un hueco interior de la forma de la base del envase, cuya pieza se calienta eléctricamente por una resistencia o por medio de una máquina de alta frecuencia, presentando un alojamiento para encajar una arandela de metal o de material plástico que quedará interpuesta entre el cuerpo del envase y la pieza referida.

Una vez colocado el envase dentro de la pieza antes descrita e interpuesta entre ambas la arandela, se coloca la

207119

-2-



pieza que ha de constituir el fondo o base, la cual presenta un reborde provisto de un canal o alojamiento para la parte terminal del envase.

5 Para efectuar la unión o soldadura se hace presión sobre la pieza que constituye el fondo mediante otra que se adapta a él sobre el reborde que podemos denominar exterior, de que va provisto. Esta pieza o punzón presenta una abertura coincidente con el fondo a soldar y que tiene por objeto constituir una cámara de aire caliente al que se dará salida por un orificio practicado en dicho punzón.

10 Esta pieza punzón tendrá la forma del fondo del envase y podrá calentarse o no.

Colocado el envase dentro de la pieza primeramente descrita, la arandela y el fondo, se presiona con el punzón, se calienta aquella pieza matriz y también el punzón si se desea, presionando con él y manteniendo esta presión y calefacción durante un tiempo que puede variar según el plástico a emplear; transcurrido dicho tiempo, se levanta el punzón, sacando el envase y quitando la arandela, quedando perfectamente soldado el fondo al cuerpo del envase.

20 Los dibujos adjuntos muestran un ejemplo de ejecución del invento.

Con la letra A se ha señalado el cuerpo del envase y con la letra B el fondo que ha de soldarse a él, apreciándose el canal o alojamiento para el borde inferior del envase, así como el pequeño resalte de la parte externa del fondo.

25 Con la letra C se ha señalado la arandela que se interpone entre el envase y la pieza matriz señalada con la letra D, la cual se calentará mediante una resistencia E.

30 Con la letra F se ha señalado la pieza que denominamos punzón en la que la letra P designa la cámara de aire calien-



te y la letra H el orificio de salida del mismo. No se ha dibujado sistema de calefacción para este punzón, pudiendo emplearse cualquier procedimiento adecuado.

Segun este dibujo, la forma de actuar del dispositivo es la siguiente: Se coloca el envase A en la pieza D, adaptandole el fondo B en interponiendo entre la pieza D la arandela C. Se presiona con el punzón F; se calienta la pieza D -siendo potestativo calentar tambien la pieza F- y transcurrido el tiempo necesario segun el material plástico empleado, se levanta la pieza F, se quita la arandela C y se separa el envase con su fondo ya soldado, de la pieza D, quedando terminado el proceso de unión.

REIVINDICACIONES

1.-Un dispositivo para efectuar la unión del fondo o base en los envases de material plástico, caracterizado por disponerse una pieza matriz de la forma correspondiente a la del envase a soldar, que aloja en su interior el cuerpo del envase en su extremidad inferior, comprimiendo tambien en su perímetro la pieza que ha de constituir el fondo de dicho envase y quedando entre ellos interpuesta una arandela de metal o de material plástico, todo ello retenido por la referida pieza matriz, la cual será calentada mediante una resistencia o máquina de alta frecuencia, llevando la pieza que ha de constituir el fondo del envase, un canal o alojamiento en el que recibe el borde inferior del cuerpo del envase.

2.-Un dispositivo segun reivindicación 1ª, caracterizado por que se dispone una pieza o punzón que presiona sobre el fondo del envase, con la forma adecuada a la del mismo, efectuando tal presión sobre un reborde o resalte exterior de dicho fondo y presentando frente a la superficie de tal fondo un hueco o cámara para el aire caliente, llevando un canal u orificio practicado en dicha pieza con el fin de poder dar salida



E 1953

para dicho aire caliente, pudiendo esta pieza punzón ser también calentada o no.

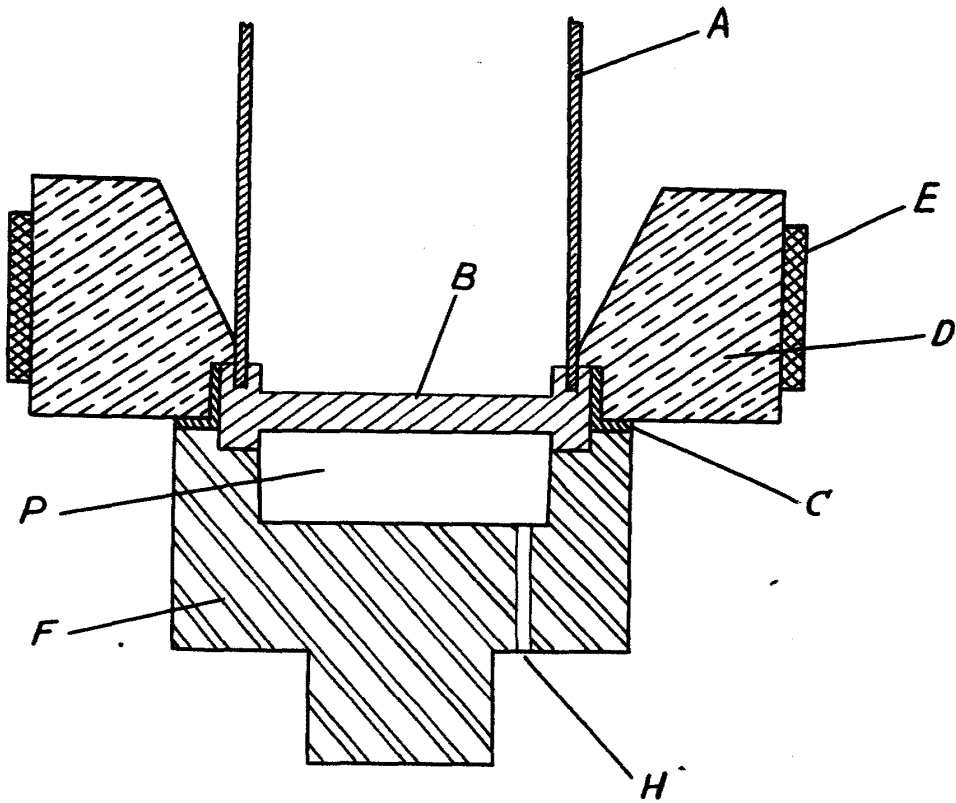
5 3.- Un dispositivo, según reivindicaciones anteriores caracterizado porque colocados en la pieza matriz el cuerpo del envase, la pieza que constituye el fondo y encajada ésta en aquél e interponiendo la arandela antes citada, se presiona dicho fondo con una pieza punzón, se calienta la pieza matriz y el punzón, si se desea, y transcurrido un tiempo variable según el material plástico empleado, se 10 levanta la pieza punzón, se quita la arandela y se separa de la pieza matriz el envase y el fondo que habrán quedado perfectamente soldados.

4.- Un dispositivo para efectuar la unión del fondo o base en los envases de material plástico.

Todo tal y como queda descrito en la presente patente que consta de cuatro hojas, foliadas, mecanografiadas y escritas por una sola cara, y aparece del dibujo adjunto.

Madrid 7 de enero de 1. 53.

BA



Escala variable
MADRID, - 7 ENE. 1953

B.A.